

台湾生申请材料

- ① 申请表（网报后打印、签字）；
- ② 有效身份证件复印件；
- ③ 台湾公证机构出具的学位证公证件（注意使用地区为北京市）。

注：应届毕业生无学位证的，则提交在学证明，无需公证，盖学校印章即可。

- ④ 毕业院校正式成绩单原件；
- ⑤ 外语水平证明（如有请提供）；
- ⑥ 两封教授或副教授（或相当职位人员）的推荐信（模板[点此下载](#)）；
- ⑦ 个人陈述（含研究计划），800 字左右，用中文撰写（模板[点此下载](#)）；
- ⑧ 发表的学术文章目录及摘要以及其他原创性研究成果证明文件（如有请提供）；

说明：1、个人陈述与专家推荐信务必要使用规定模版。

2、个人陈述请控制在 4 页以内，且务必在“申请人签名”处签名。其它关于个人的详细经历与说明，可作为个人简历和其它材料提交。

3、专家推荐信“申请院系”处填写软件与微电子学院；“专业”处根据报考情况填写软件工程或电子与通信工程。